

证券代码：688123

证券简称：聚辰股份

公告编号：2026-045

聚辰半导体股份有限公司

关于 2026 年半年度业绩预增的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 经财务部门初步测算，公司预计 2026 年 1-6 月实现营业收入 60,192.17 万元，同比增长 4.71%；归属于上市公司股东的净利润为 52,533.42 万元，同比增长 156.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 9,347.12 万元，同比下降 47.30%。

剔除股份支付费用影响后，公司预计 2026 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润 56,745.48 万元，较上年同期增长 167.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 13,559.18 万元，较上年同期下滑 26.48%。

● 公司预计 2026 年 1-6 月研发投入达 12,906.44 万元，同比增长 25.71%。报告期内，公司各项新产品开发进展顺利，其中配套新一代 eSSD 模组和 CXL 内存模组的 VPD 芯片已顺利通过目标客户的测试认证，并将搭载在目标客户的模组样品上，分发给各终端客户进行测试验证。

● 进入第二季度以来，公司 DDR5 SPD 芯片、应用于汽车电子和工业控制领域的高可靠性 EEPROM 芯片的出货量较第一季度实现快速增长。公司预计第二季度实现营业收入 32,192.72 万元，环比增长 14.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,654.99 万元，环比增长 147.20%；剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8,715.28 万元，环比增长 79.92%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2026 年 1-6 月实现营业收入 60,192.17 万元，同比增长 4.71%。

2、经财务部门初步测算，公司预计 2026 年 1-6 月的研发投入达 12,906.44 万元，同比增长 25.71%。

3、经财务部门初步测算，公司预计 2026 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润 52,533.42 万元，较上年同期增长 156.07%；剔除股份支付费用影响后，公司预计 2026 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润 56,745.48 万元，较上年同期增长 167.40%。

4、经财务部门初步测算，公司预计 2026 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,347.12 万元，同比下降 47.30%；剔除股份支付费用影响后，公司预计 2026 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,559.18 万元，较上年同期下滑 26.48%。

二、上年同期业绩情况

1、2025 年 1-6 月，公司实现营业收入 57,485.54 万元。

2、2025 年 1-6 月，公司研发投入为 10,267.08 万元。

3、2025 年 1-6 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润 20,515.06 万元；剔除股份支付费用影响后，公司归属于上市公司股东的净利润为 21,221.50 万元。

4、2025 年 1-6 月，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,736.03 万元；剔除股份支付费用影响后，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 18,442.48 万元。

三、本期业绩变化的主要原因

（一）主营业务经营情况

报告期内，公司各下游应用市场需求结构分化明显，不同产品的市场销售情况存在较大差异。受存储颗粒产能供应紧张、价格大幅上涨影响，PC 和智能手机终端市场短期承压，公司应用于 PC 和智能手机领域的部分产品的销售收入较上年同期存在一定幅度的下滑。但受益于近年来公司持续完善在存储芯片领域的布局，公司应用于汽车电子和工业控制领域的高可靠性 EEPROM 芯片、NOR Flash 芯片和 NFC 芯片的出货量较上年同期实现较快速增长，较好地缓解了 PC 和智能手机市场需求短期波动对公司产品销售带来的影响，带动公司 2026 年 1-6 月实现营业收入 60,192.17 万元，同比增长 4.71%。与此同时，公司持续提升研发水平，上半年研发投入达 12,906.44 万元，同比增长 25.71%，为进一步丰富公司的业务结构、提升公司的盈利能力和综合竞争力奠定了坚实基础。

进入第二季度以来，随着部分下游应用市场需求的回暖，SOCAMM2 与 LPCAMM2 等新型内存模组的陆续商用，以及公司不断加强对产品的推广、销售及综合服务力度，公司 DDR5 SPD 芯片、应用于汽车电子和工业控制领域的高可靠性 EEPROM 芯片的出货量较第一季度实现快速增长，带动公司综合毛利率较第一季度增加约 4.8 个百分点，成为公司收入规模扩张和盈利能力提升的重要驱动力。公司第二季度实现营业收入 32,192.72 万元，环比增长 14.98%，为历史同期最好成绩；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,654.99 万元，环比增长 147.20%；剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8,715.28 万元，环比增长 79.92%。报告期内，公司各项新产品开发进展顺利，其中配套新一代 eSSD 模组和 CXL 内存模组的 VPD 芯片已顺利通过目标客户的测试认证，并将搭载在目标客户的模组样品上，分发给各终端客户进行测试验证。

（二）业绩变化的主要原因

报告期内，受公司产品销售结构变动、研发投入扩大以及 2025 年限制性股票激励计划股份支付费用摊销影响，公司经营端盈利短期承压，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下滑 47.30%；剔除股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下滑 26.48%。

经财务部门初步测算，公司计入 2026 年 1-6 月的非经常性损益金额约为 43,186.30 万元，较上年同期大幅增长，主要系公司于 2026 年 4 月使用约六千万元自有资金参与盛合晶微半导体有限公司科创板 IPO 战略配售，获配股数约 304.88 万股，本期所持有相关股票产生较大规模公允价值变动损益所致。

受上述因素综合影响，公司预计 2026 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润 52,533.42 万元，较上年同期增长 156.07%；剔除股份支付费用影响后，公司预计 2026 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润 56,745.48 万元，较上年同期增长 167.40%。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。以上预告数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司 2026 年半年度报告中披露的数据存在差异，具体财务数据应当以公司披露的 2026 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日